

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于公司及产业基金对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资事项概述

为积极布局车用半导体前沿技术，有效把握三代半导体相关技术的产业发展机遇，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）与以色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称“VisIC 公司”）洽谈股权合作，并由苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号产业基金”）累计投资 2,500 万美元，持有 VisIC 公司 17.12% 的股权，具体详见公司于 2022 年 2 月 8 日发布的《关于产业基金对外投资及产业基金完成私募基金备案的公告》（临 2022-003），目前投资交割的相关手续已履行完毕。

为进一步深化与以色列 VisIC 公司的股权合作，更好推进未来双方的战略合作与业务协同，公司、晶方贰号产业基金本次拟合计增加投资 5,000 万美元，向 VisIC 公司境外股东购买其所持有的 VisIC 公司 34% 股权，其中公司拟出资 1,000 万美元，向 VisIC 公司境外股东购买其所持有的 VisIC 公司 6.80% 股权，晶方贰号产业基金拟出资 4,000 万美金，向 VisIC 公司境外股东购买其所持有的 VisIC 公司 27.20% 股权，晶方贰号产业基金的资金来源为：公司作为有限合伙人入伙增资晶方贰号产业基金，认缴出资人民币 13,986 万元；苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东吴产业基金”）作为有限合伙人入伙增资晶方贰号产业基金，认缴出资人民币 6,000 万元；苏州鼎太鲲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎太鲲投资”）作为有限合伙人入伙增资晶方贰号产业基金，认缴出资人民币 1,460 万元；农银国际投资（苏州）有限公司（以下简称“农银国际”）作为有限合伙人入伙增资晶方贰号产业基金，认缴出资人民币

1,460 万元；湖南三安半导体有限责任公司（以下简称“湖南三安”）作为有限合伙人入伙增资晶方贰号产业基金，认缴出资人民币 2,190 万元。苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“园区产业基金”）作为晶方贰号产业基金的有限合伙人增加认缴出资人民币 913 万元；赵东明先生作为晶方贰号产业基金的有限合伙人增加认缴出资人民币 1,000 万元；王蔚先生作为晶方贰号产业基金的有限合伙人增加认缴出资人民币 22,041 万元（针对本次购买 VisIC 公司股权的认缴出资为 2,190 万元，剩余认缴出资 19,851 万元根据基金未来投资需求进行缴款），上述有限合伙人本次合计增加认缴出资人民币 49,050 万元（针对本次购买 VisIC 公司股权的认缴出资为 29,199 万元，对应 4,000 万美金，剩余认缴额度 19,851 万元根据未来投资需求进行缴款）。投资完成后，公司将持有 VisIC 公司 6.80% 股权，晶方贰号产业基金将合计持有 VisIC 公司 44.32% 股权。

二、晶方贰号产业基金基本情况

（一）、本次增资前基本情况

名称：苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA27AX650N

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州嘉睿资本管理有限公司（委派代表：谢旻宵）

成立日期：2021 年 10 月 28 日

合伙期限：10 年

注册资本：人民币 16,350 万元

经营场所：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 栋 206 室

经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：本次增资前各合伙人的认缴出资情况如下表

合伙人类别	名称	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
-------	----	------	-----------	--------

普通合伙人	苏州嘉睿资本管理有限公司	货币	1	0.01%
有限合伙人	苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	8,225	50.30%
有限合伙人	苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	货币	5,525	33.79%
有限合伙人	赵东明	货币	1,056	6.46%
有限合伙人	王蔚	货币	1,056	6.46%
有限合伙人	苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	487	2.98%
合计		-	16,350	100.00%

（二）、本次新增认缴出资基本情况

本次公司、东吴产业基金、鼎太鲲投资、农银国际、湖南三安将作为新的有限合伙人，入伙增资晶方贰号产业基金，其中公司认缴出资人民币 13,986 万元，东吴产业基金认缴出资人民币 6,000 万元，鼎太鲲投资认缴出资人民币 1,460 万元（持股 2.232%），农银国际认缴出资人民币 1,460 万元；湖南三安认缴出资人民币 2,190 万元。园区产业基金、赵东明、王蔚作为晶方贰号产业基金的既有有限合伙人，对晶方贰号产业基金增加认缴出资，其中园区产业基金增加认缴出资人民币 913 万元，赵东明增加认缴出资人民币 1,000 万元，王蔚增加认缴出资人民币 22,041 万元（针对本次购买 VisIC 公司股权的认缴出资为 2,190 万元，剩余认缴出资 19,851 万元根据基金未来投资需求进行缴款），上述有限合伙人本次合计增加认缴出资人民币 49,050 万元，增加认缴出资后各合伙人的具体认缴出资情况如下表。

合伙人名称	类别	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
苏州嘉睿资本管理有限公司	普通合伙人	货币	1	0.0015%
苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	8,225	12.576%
苏州晶方半导体科技股份有限公司	有限合伙人	货币	13,986	21.387%
苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	货币	6,438	9.843%

赵东明	有限合伙人	货币	2,056	3.144%
王蔚	有限合伙人	货币	23,097	35.316%
苏州东吴产业并购引导基金	有限合伙人	货币	6,000	9.174%
苏州鼎太鲲创业投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	货币	1,460	2.232%
农银国际投资(苏州)有限公司	有限合伙人	货币	1,460	2.232%
湖南三安半导体有限责任公司	有限合伙人	货币	2,190	3.349%
苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	货币	487	0.745%
合计			65,400	100.00%

(三)、本次新增认缴出资后公司在晶方贰号产业基金的持股变化情况

晶方贰号产业基金本次新增认缴出资前,公司通过持股 99%的苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶方壹号产业基金”)持有其 50.3%的股权比例。

晶方贰号产业基金本次新增认缴出资后,公司及晶方壹号产业基金将合计持有其 33.96%的股权比例,公司及公司所控制的主体不再是晶方贰号产业基金持股 50%以上的股东,也不是其控股股东。

三、公司及晶方贰号产业基金本次对外投资基本情况

(一) 向境外股东购买其所持有的 VisIC 公司股权

近日,公司及晶方贰号产业基金与以色列 VisIC 公司境外股东签署了《股份购买协议》等相关协议,协议约定晶方贰号产业基金出资 4,000 万元美元,向 VisIC 公司境外相关股东购买其所持有的以色列 VisIC 公司 27.20%股权,公司出资 1,000 万美元,向 VisIC 公司境外相关股东购买其所持有的以色列 VisIC 公司 6.80%股权。

(二)、投资标的基本情况

1、VisIC 公司基本情况

公司名称: VisIC Technologies Ltd.,

成立日期: 2010 年 6 月 30 日

注册地址：7 Golda Meir Street, Ness Ziona, 7403650, Israel.

注册股份数：10,219,769 股（2021 年 11 月 30 日）

VisIC 公司成立于 2010 年，总部位于以色列 Ness Ziona，是第三代半导体领域 GaN（氮化镓）器件的全球领先者，团队拥有深厚的氮化镓技术知识和数十年的产品经验基础。VisIC 公司申请布局了 D3GaN（氮化镓）技术的关键专利，在此基础上成功开发了硅基氮化镓大功率晶体管和模块，正在将其推向 EV 电动汽车市场，其高效可靠的氮化镓产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射频和功率器件等应用领域。

（三）、涉及审批事项该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。

四、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组

（一）与关联人共同对晶方贰号产业基金增资

1、关联关系介绍

王蔚先生为公司董事长、总经理，本次公司与其共同以货币资金对晶方贰号产业基金进行增资，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联人基本情况

王蔚：男，中国国籍，身份证号：320504196602*****，有丰富的通信、电子、PCB 等领域的工作经验，非常熟悉 EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate 等。2005 年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004 年任职于 Camtek Ltd.，担任大中国区总经理。

3、历史同类交易情况

2021 年 12 月，公司通过晶方壹号产业基金与王蔚先生共同出资投资晶方贰号产业基金。完成出资后，公司通过晶方壹号产业基金投资人民币 6,600 万元，当时持有晶方贰号产业基金 50.38% 股份，王蔚先生投资人民币 1,056 万元，当时持有晶方贰号产业基金 8.06% 股份，双方出资方式均为货币资金。具体详见公司于 2021 年 12 月 18 日发布的《关于产业基金对外投资的公告》（临 2021-078）。

4、本次交易履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。

(二) 与关联公司共同向境外股东购买其所持有的 VisIC 公司股权

1、关联关系介绍

本次交易完成后，公司与晶方壹号产业基金将共同持有晶方贰号产业基金 33.963% 股份，本次公司与晶方贰号产业基金共同以货币资金、以相同的价格向境外股东购买其所持有的 VisIC 公司股权，该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联方基本情况

关联方晶方贰号产业基金的基本情况详见本公告第二部分之“晶方贰号产业基金基本情况”。

3、历史同类交易情况

不适用。

4、本次交易履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见。

五、对外投资对上市公司的影响及风险提示

(一) 投资目的

晶方科技通过晶方贰号产业基金并对以色列 VisIC 公司进行投资，有利于进一步深化与以色列 VisIC 公司的股权合作，更好推进未来双方的战略合作与业务协同。VisIC 公司为全球领先的第三代半导体 GaN (氮化镓) 器件设计公司，其专利技术的氮化镓功率器件可广泛应用于快充、电动汽车、5G 基站和数据中心、高功率激光等应用领域。目前 VisIC 公司正积极与国际知名汽车厂商合作，共同开发 800V 及以上车载高功率氮化镓模块，为新型电动汽车提供更高转换效率，

更小模块体积和更高可靠性的功率器件产品。公司依据自身战略规划投资 VisIC 公司，进一步加强股权合作，积极布局前沿半导体技术，并充分利用自身先进封装方面的产业和技术能力，以期能有效把握三代半导体在新能源汽车领域产业发展机遇。

（二）可能存在的风险

股权投资项目投资周期较长，投资过程中受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等外部因素、以及被投公司自身技术开发与市场拓展进展不利的影 响，可能会存在投资损失的风险。公司将充分行使相关权利，做好投资后的协同整合与风险管理工作，整合各项资源、有效降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日